

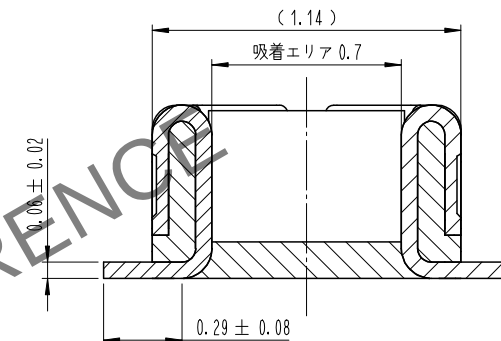
PART No.	CODE No.	POS.	B	C	D
BM23PF0.8-10DP-0.35V(51)	-	10	3.49	1.40	2.70
BM23PF0.8-14DP-0.35V(51)	-	14	4.19	2.10	3.40
BM23PF0.8-20DP-0.35V(51)	-	20	5.24	3.15	4.45
BM23PF0.8-24DP-0.35V(51)	-	24	5.94	3.85	5.15
BM23PF0.8-30DP-0.35V(51)	-	30	6.99	4.90	6.20
BM23PF0.8-40DP-0.35V(51)	-	40	8.74	6.65	7.95
BM23PF0.8-42DP-0.35V(51)	-	42	9.09	7.00	8.30
BM23PF0.8-44DP-0.35V(51)	-	44	9.44	7.35	8.65
BM23PF0.8-46DP-0.35V(51)	-	46	9.79	7.70	9.00
BM23PF0.8-50DP-0.35V(51)	-	50	10.49	8.40	9.70
BM23PF0.8-54DP-0.35V(51)	-	54	11.19	9.10	10.40
BM23PF0.8-64DP-0.35V(51)	-	64	12.94	10.85	12.15

注 1. 平坦度は0.08mm以下となります。

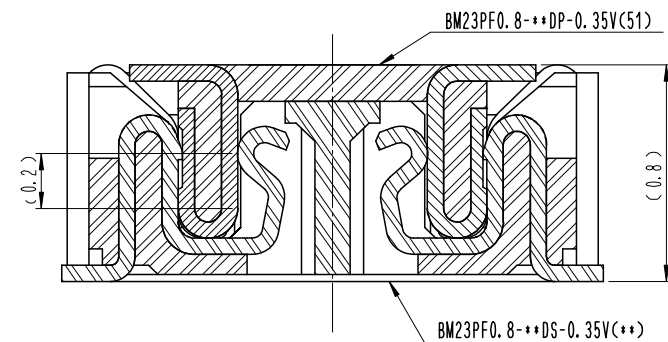
- ② 端子めっき仕様
接触部 : 金めっき 0.05μm MIN.
実装部 : 金めっき 0.05μm MIN.
下地 : ニッケルめっき 1μm MIN.
(表面 : 封孔処理)
- ③ 補強金具めっき仕様
接触部 : 金めっき 0.05μm MIN.
下地 : ニッケルめっき 1μm MIN.
(表面 : 封孔処理)
- ④ 図示近傍に HRSマーク または CAV No を表示します。
- ⑤ 製品側面に凹みを設ける場合があります。

COUNT	DESCRIPTION OF REVISIONS	B	Y	CHKD	DATE	COUNT	DESCRIPTION OF REVISIONS	B	Y	CHKD	DATE
3	RE-6-1784	PSH	JHW	20.04.09							
2	RE-6-1994	PSH	JHW	20.09.07							

A:A(50:1)

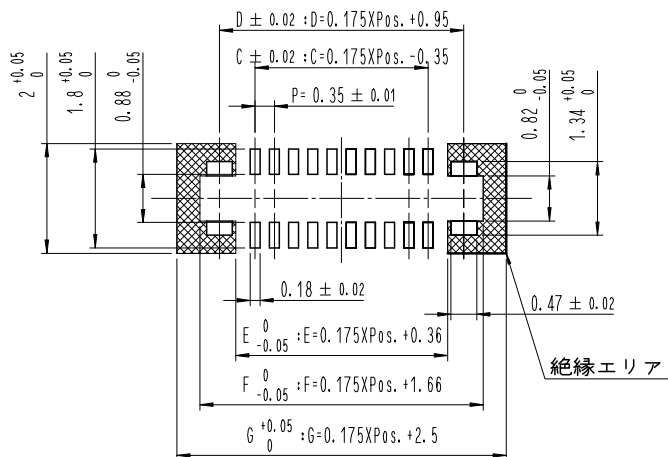


嵌合断面図 (50:1)



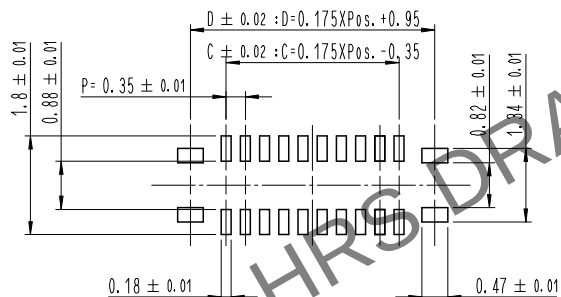
4	PS	CLEAR. エンボスキャリアテープ 					
3	りん青銅		7	PS	CLEAR. 補強用カラー		
2	りん青銅		6	PS	BLACK. プラスチックリール		
1	LCP	UL94 V-0, BLACK	5	POLYESTER	CLEAR. カバーテープ		
NO.	MATERIAL	FINISH, REMARKS	NO.	MATERIAL	FINISH, REMARKS		
REMARKS			DRAWN	DESIGNED	CHECKED	APPROVED	RELEASED
			S. H. MOON	S. H. MOON	H. W. JO	T. S. KANG	17.01.26
			17.01.26	17.01.26	17.01.26	17.01.26	17.01.26
CODE NO. (OLD)		DRAWING NO.	PART NO.				
	SCALE 10:1	JDC3-*****	BM23PF0.8-**DP-0.35V(51)				
	UNITS	 HIROSE KOREA CO., LTD.	CODE NO		CL 66*-**-*-51		1/3

7>◆推奨基板パターン図



◆推奨メタルマスク開口部図

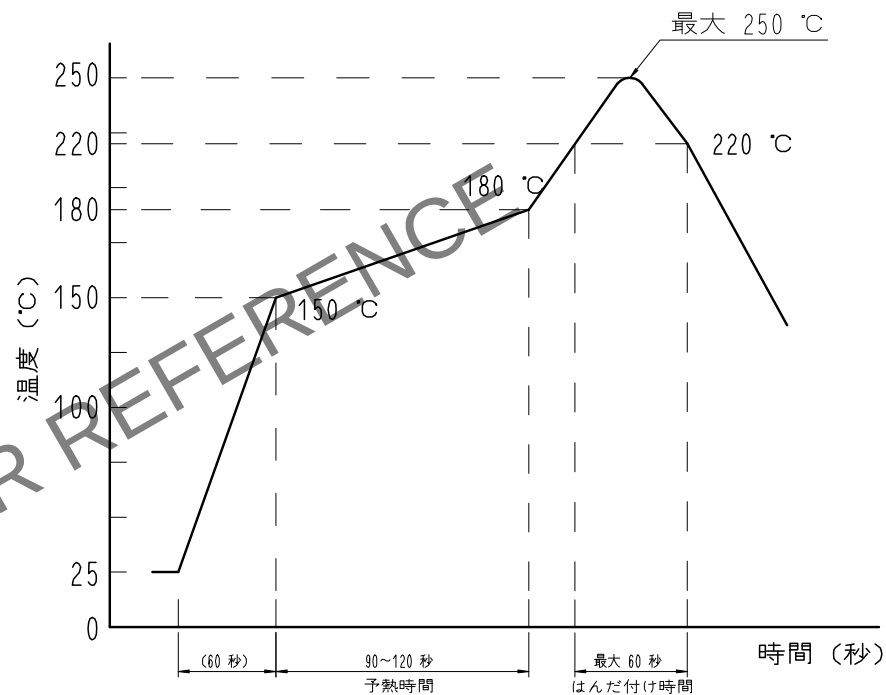
メタルマスク厚 : 100 μm



△

POS.	C	D	E	F	G
10	1.40	2.70	2.11	3.41	4.25
14	2.10	3.40	2.81	4.11	4.95
20	3.15	4.45	3.86	5.16	6.00
24	3.85	5.15	4.56	5.86	6.70
30	4.90	6.20	5.61	6.91	7.75
40	6.65	7.95	7.36	8.66	9.50
42	7.00	8.30	7.71	9.01	9.85
44	7.35	8.65	8.06	9.36	10.20
46	7.70	9.00	8.41	9.71	10.55
50	8.40	9.70	9.11	10.41	11.25
54	9.10	10.40	9.81	11.11	11.95
64	10.85	12.15	11.56	12.86	13.70

△6>鉛フリークリームはんだの温度プロファイル(推奨)



リフロー方式 : N₂ リフロー

リフロー回数 : 2回以下

1)本加熱

220℃以上 60秒以下 (ピーク温度250℃)

2)予備加熱

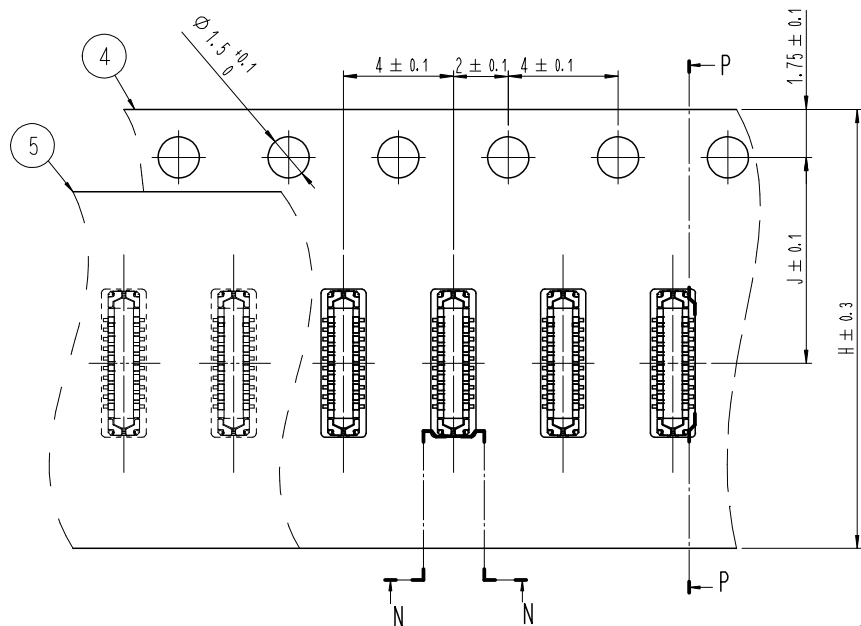
150~180℃ 90~120秒

6> 温度はコネクタリード部近辺の基板表面温度を表します。
この温度プロファイルは上記適用条件のものです。
クリームはんだの種類、メーカー、基板サイズ、その他実装
部材等の条件により異なる場合がありますので、実装状態
を十分ご確認の上ご使用願います。

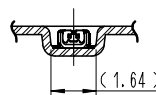
7> 上記の推奨条件と、異なる設定を行なう場合は、弊社にご連絡を下さい。

DRAWING NO.	JDC3-*****	PART NO.	BM23PF0.8-**-DP-0.35V(51)
SCALE	10:1	CODE NO	CL 66**-*****-51
UNITS	mm		
	HIROSE KOREA CO., LTD.		

エンボスキャリアテープ (5:1)

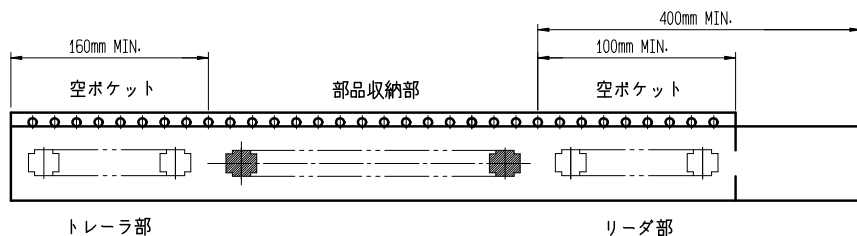


N-N (5:1)

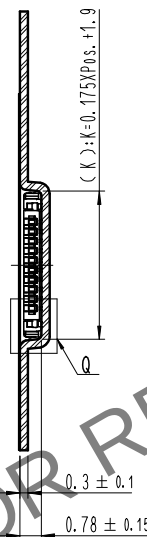


引き出し方向

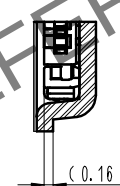
10 テーピング (Free)



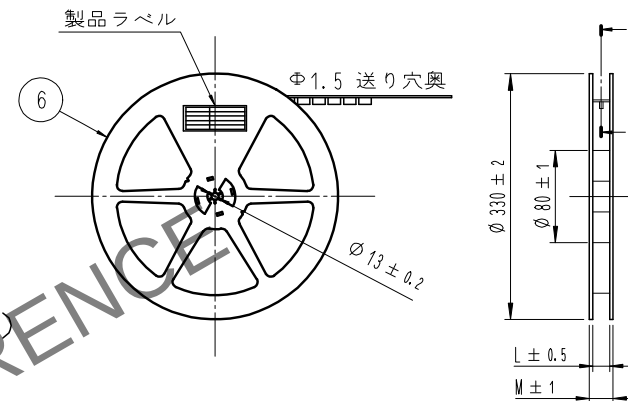
P-P (5:1)



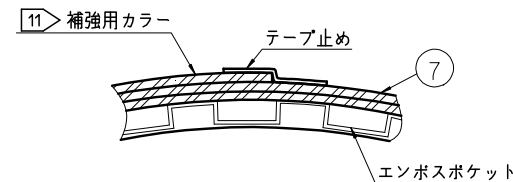
Q (10:1)



リール形状および寸法 (Free)



S-S (FREE)



製品ラベル詳細

SUPPLIER	HIROSE
QUANTITY	10,000個
PART NO.	BM23PF0.8-**-DP-0.35V(51)
CODE NO.	CL 66**-*****-51
DATE OF MANUFACTURED	2024.05.01
生産月日	年 月 日
図番	** ** *
品名	BM23PF0.8-**-DP-0.35V(51)
納入数量	10,000個
納入者	HIROSE KOREA

8 . 1リール10,000個巻きです。

9 . () 内寸法は参考寸法です。

10 . エンボス梱包仕様は JIS C 0806 (IEC60286-3) に準拠しております。

11 . エンボスリールの外周(終端側)にエンボスキャリアテープ・カバーテープの補強を目的としたポリスチレン材の補強カラーを巻きつけております。

DRAWING NO.	JDC3-*****	PART NO.	BM23PF0.8-**-DP-0.35V(51)
SCALE	10:1	CODE NO.	CL 66**-*****-51
UNITS	mm		

HIROSE KOREA CO., LTD.